

目次

1. パッケージビジネスの現状と展望

1-1 パッケージビジネスの現状と展望	2
1-1-1 世界半導体産業の売上推移と展望	3
1-1-2 世界半導体後工程市場・世界 OSAT 上位 20 社の売上推移と展望 "	3
1-1-3 世界パッケージ市場・世界 OSAT 上位 20 社の売上推移と展望 "	4
1-1-4 世界 OSAT 上位 20 社の売上推移と展望	4
1-1-5 世界 OSAT 上位 20 社の企業別売上一覧	5
1-1-6 世界 OSAT 上位 20 社の国籍別社数構成比	6
1-1-7 世界 OSAT 上位 20 社の国籍別売上構成比 (2022 年度)	6
1-2 後工程製造拠点および設備投資状況	7
1-2-1 後工程工場世界分布 (日本を除く)	8
1-2-2 世界 OSAT 上位 20 社の後工程工場世界分布 (日本を除く) "	8
1-2-3 世界半導体設備投資の推移と展望	9
1-2-4 世界半導体後工程設備投資の推移と展望	9
1-2-5 世界 OSAT 上位 20 社の企業別後工程設備投資一覧	10
1-2-6 世界 OSAT 上位 20 社の国籍別設備投資構成比 (2022 年度)	10

2. 国内半導体企業のパッケージ事業戦略

2-1 東芝デバイス & ストレージ株式会社・キオクシア株式会社	12
1) 事業戦略	12
2) 設備投資	13
3) 開発と今後の方向性	14
4) 半導体売上状況	15
5) 設備投資状況	15
6) 工場別提供パッケージ	16
7) 各工場のライン別一覧	17
2-2 ソニー株式会社	23
1) 事業戦略	23
2) 設備投資	24
3) 開発と今後の方向性	25
4) 半導体売上状況	26
5) 設備投資状況	26
6) 工場別提供パッケージ	27
7) 各工場のライン別一覧	28
2-3 ルネサスエレクトロニクス株式会社	32
1) 事業戦略	32
2) 設備投資	33
3) 開発と今後の方向性	33
4) 半導体売上状況	34
5) 設備投資状況	34
6) 工場別提供パッケージ	35
7) 各工場のライン別一覧	36
2-4 ローム株式会社	44
1) 事業戦略	44
2) 設備投資	45
3) 開発と今後の方向性	45
4) 半導体売上状況 - (1) 全社製品別	47
4) 半導体売上状況 - (2) 後工程関連	47
5) 設備投資状況 - (1) 全社製品別	48
5) 設備投資状況 - (2) 後工程関連	48
6) 工場別提供パッケージ	49
7) 各工場のライン別一覧	50
2-5 シャープ株式会社	60

1) 事業戦略	60
2) 設備投資	61
3) 開発と今後の方向性	61
4) 半導体売上状況	62
5) 設備投資状況	62
6) 工場別提供パッケージ	63
7) 各工場のライン別一覧	64
2-6 三菱電機株式会社	68
1) 事業戦略	68
2) 設備投資	69
3) 開発と今後の方向性	69
4) 半導体売上状況	71
5) 設備投資状況	71
6) 工場別提供パッケージ	72
7) 各工場のライン別一覧	73
2-7 富士電機株式会社	81
1) 事業戦略	81
2) 設備投資	81
3) 開発と今後の方向性	82
4) 半導体売上状況	83
5) 設備投資状況	83
6) 工場別提供パッケージ	84
7) 各工場のライン別一覧	85
2-8 サンケン電気株式会社	92
1) 事業戦略	92
2) 設備投資	93
3) 開発と今後の方向性	93
4) 半導体売上状況	94
5) 設備投資状況	94
6) 工場別提供パッケージ	95
7) 各工場のライン別一覧	96
2-9 浜松ホトニクス株式会社	102
1) 事業戦略	102
2) 設備投資	102
3) 開発と今後の方向性	103
4) 半導体売上状況	104
5) 設備投資状況	104
6) 工場別提供パッケージ	105
7) 各工場のライン別一覧	106
2-10 ミネベアミツミ株式会社	111
1) 事業戦略	111
2) 設備投資	112
3) 開発と今後の方向性	113
4) 半導体売上状況	114
5) 設備投資状況	114
6) 工場別提供パッケージ	115
7) 各工場のライン別一覧	116
2-11 セイコーエプソン株式会社	119
1) 事業戦略	119
2) 設備投資	119
3) 開発と今後の方向性	119
4) 半導体売上状況	120
5) 設備投資状況	120
6) 工場別提供パッケージ	121
7) 各工場のライン別一覧	122
2-12 日清紡マイクロデバイス株式会社	125
1) 事業戦略	125
2) 設備投資	126
3) 開発と今後の方向性	126
4) 半導体売上状況	127
5) 設備投資状況	127

Semiconductor Package Business Strategy 2024

6) 工場別提供パッケージ	128	3-2 Micron Technology	188
7) 各工場のライン別一覧	129	1) 事業戦略	188
2-13 新電元工業株式会社	131	2) 設備投資	189
1) 事業戦略	131	3) 開発と今後の方向性	190
2) 設備投資	131	4) 半導体売上状況	191
3) 開発と今後の方向性	132	5) 設備投資状況	191
4) 半導体売上状況	133	6) 工場別提供パッケージ	192
5) 設備投資状況	133	7) 各工場のライン別一覧	193
6) 工場別提供パッケージ	134	3-3 Texas Instruments	199
7) 各工場のライン別一覧	135	1) 事業戦略	199
2-14 スタンレー電気株式会社	139	2) 設備投資	200
1) 事業戦略	139	3) 開発と今後の方向性	200
2) 設備投資	140	4) 半導体売上状況	202
3) 開発と今後の方向性	140	5) 設備投資状況	202
4) 半導体売上状況	141	6) 工場別提供パッケージ	203
5) 設備投資状況	141	7) 各工場のライン別一覧	204
6) 工場別提供パッケージ	142	3-4 Analog Devices	210
7) 各工場のライン別一覧	143	1) 事業戦略	210
2-15 コーデンシ株式会社	147	2) 設備投資	211
1) 事業戦略	147	3) 開発と今後の方向性	212
2) 設備投資	148	4) 半導体売上状況	213
3) 開発と今後の方向性	148	5) 設備投資状況	213
4) 半導体売上状況	149	6) 工場別提供パッケージ	214
5) 設備投資状況	149	7) 各工場のライン別一覧	215
6) 工場別提供パッケージ	150	3-5 ON Semiconductor	218
7) 各工場のライン別一覧	151	1) 事業戦略	218
2-16 京セラ株式会社	154	2) 設備投資	219
1) 事業戦略	154	3) 開発と今後の方向性	220
2) 設備投資	154	4) 半導体売上状況	221
3) 開発と今後の方向性	155	5) 設備投資状況	221
4) 半導体売上状況	156	6) 工場別提供パッケージ	222
5) 設備投資状況	156	7) 各工場のライン別一覧	223
6) 工場別提供パッケージ	157	3-6 Samsung Electronics	234
7) 各工場のライン別一覧	158	1) 事業戦略	234
2-17 株式会社京都セミコンダクター	161	2) 設備投資	235
1) 事業戦略	161	3) 開発と今後の方向性	236
2) 設備投資	162	4) 半導体売上状況	237
3) 開発と今後の方向性	162	5) 設備投資状況	237
4) 半導体売上状況	163	6) 工場別提供パッケージ	238
5) 設備投資状況	163	7) 各工場のライン別一覧	239
6) 工場別提供パッケージ	164	3-7 SK Hynix	242
7) 各工場のライン別一覧	165	1) 事業戦略	242
2-18 株式会社オリジン	167	2) 設備投資	243
1) 事業戦略	167	3) 開発と今後の方向性	243
2) 設備投資	167	4) 半導体売上状況	244
3) 開発と今後の方向性	168	5) 設備投資状況	244
4) 半導体売上状況	169	6) 工場別提供パッケージ	245
5) 設備投資状況	169	7) 各工場のライン別一覧	246
6) 工場別提供パッケージ	170	3-8 TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation)	249
7) 各工場のライン別一覧	171	1) 事業戦略	249
3. 海外半導体企業のパッケージ事業戦略		2) 設備投資	250
3-1 Intel Corporation	174	3) 開発と今後の方向性	251
1) 事業戦略	174	4) 半導体売上状況	253
2) 設備投資	176	5) 設備投資状況	253
3) 開発と今後の方向性	177	6) 工場別提供パッケージ	254
4) 半導体売上状況	179	7) 各工場のライン別一覧	255
5) 設備投資状況	179	3-9 STMicroelectronics	260
6) 工場別提供パッケージ	180	1) 事業戦略	260
7) 各工場のライン別一覧	181	2) 設備投資	261

Semiconductor Package Business Strategy 2024

7) 各工場のライン別一覧	411	4) 半導体売上状況	519
5-4 Tongfu Microelectronics (通富微電子)	419	5) 設備投資状況	519
1) 事業戦略	419	6) 工場別提供パッケージ	520
2) 設備投資	420	7) 各工場のライン別一覧	521
3) 開発と今後の方向性	421	5-12 OSE (Orient Semiconductor Electronics)	525
4) 半導体売上状況	422	1) 事業戦略	525
5) 設備投資状況	422	2) 設備投資	526
6) 工場別提供パッケージ	423	3) 開発と今後の方向性	526
7) 各工場のライン別一覧	424	4) 半導体売上状況	527
5-5 Powertech Technology	433	5) 設備投資状況	527
1) 事業戦略	433	6) 工場別提供パッケージ	528
2) 設備投資	434	7) 各工場のライン別一覧	529
3) 開発と今後の方向性	435	5-13 Shuzou Good Ark Electronics	530
4) 半導体売上状況	437	1) 事業戦略	530
5) 設備投資状況	437	2) 設備投資	530
6) 工場別提供パッケージ	438	3) 開発と今後の方向性	531
7) 各工場のライン別一覧	439	4) 半導体売上状況	532
5-6 Tianshui Huatian Technology (TSHT)	452	5) 設備投資状況	532
1) 事業戦略	452	6) 工場別提供パッケージ	533
2) 設備投資	453	7) 各工場のライン別一覧	534
3) 開発と今後の方向性	454	5-14 Nepes	537
4) 半導体売上状況	455	1) 事業戦略	537
5) 設備投資状況	455	2) 設備投資	538
6) 工場別提供パッケージ	456	3) 開発と今後の方向性	539
7) 各工場のライン別一覧	457	4) 半導体売上状況	540
5-7 UTAC	468	5) 設備投資状況	540
1) 事業戦略	468	6) 工場別提供パッケージ	541
2) 設備投資	469	7) 各工場のライン別一覧	542
3) 開発と今後の方向性	470	5-15 Carsem	548
4) 半導体売上状況	472	1) 事業戦略	548
5) 設備投資状況	472	2) 設備投資	549
6) 工場別提供パッケージ	473	3) 開発と今後の方向性	549
7) 各工場のライン別一覧	474	4) 半導体売上状況	550
5-8 Chipbond Technology	484	5) 設備投資状況	550
1) 事業戦略	484	6) 工場別提供パッケージ	551
2) 設備投資	485	7) 各工場のライン別一覧	552
3) 開発と今後の方向性	486	5-16 Formosa Advanced Technologies (FATC)	555
4) 半導体売上状況	487	1) 事業戦略	555
5) 設備投資状況	487	2) 設備投資	556
6) 工場別提供パッケージ	488	3) 開発と今後の方向性	556
7) 各工場のライン別一覧	489	4) 半導体売上状況	557
5-9 ChipMOS Technologies	496	5) 設備投資状況	557
1) 事業戦略	496	6) 工場別提供パッケージ	558
2) 設備投資	497	7) 各工場のライン別一覧	559
3) 開発と今後の方向性	497	5-17 Walton Advanced Engineering	560
4) 半導体売上状況	499	1) 事業戦略	560
5) 設備投資状況	499	2) 設備投資	561
6) 工場別提供パッケージ	500	3) 開発と今後の方向性	561
7) 各工場のライン別一覧	501	4) 半導体売上状況	562
5-10 HANA Micron	506	5) 設備投資状況	562
1) 事業戦略	506	6) 工場別提供パッケージ	563
2) 設備投資	507	7) 各工場のライン別一覧	564
3) 開発と今後の方向性	508	5-18 Signetics	570
4) 半導体売上状況	509	1) 事業戦略	570
5) 設備投資状況	509	2) 設備投資	571
6) 工場別提供パッケージ	510	3) 開発と今後の方向性	571
7) 各工場のライン別一覧	511	4) 半導体売上状況	572
5-11 SFA Semicon	516	5) 設備投資状況	572
1) 事業戦略	516	6) 工場別提供パッケージ	573
2) 設備投資	517	7) 各工場のライン別一覧	574
3) 開発と今後の方向性	518		

5-19 China Wafer Level CSP	575
1) 事業戦略	575
2) 設備投資	576
3) 開発と今後の方向性	576
4) 半導体売上状況	577
5) 設備投資状況	577
6) 工場別提供パッケージ	578
7) 各工場のライン別一覧	579